

Title (en)

Method and system for sorting flat postal packages

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Sortieren von flachen Postsendungen

Title (fr)

Procédé et dispositif de tri d'envois postaux plats

Publication

**EP 2067535 A1 20090610 (DE)**

Application

**EP 08170817 A 20081205**

Priority

DE 102007058580 A 20071205

Abstract (en)

The method involves carrying out sorting operations in respective adjacent segments (42, 44). Overflow packages in one of the sorting operations are allocated to a storage module (46f) which is closed due to filling process. The overflow packages are deposited in one of storage modules (46a-46e), and are interposed in a sorting process of one of the sorting operations. Flat postal packages (52) are analyzed before sorting in a packaging time. Undetected postal packages are deposited in other storage modules during the analysis. An independent claim is also included for a device for sorting flat postal package using a sorting device.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zum Sortieren von flachen Postsendungen (P 1 - P n , 52) angegeben, mit dem eine Gangfolgesortierung zügig und zuverlässig durchgeführt werden kann. Bei dem Verfahren wird in einem ersten Segment (42) mit mindestens N Speichermodule (46a - k) einer Sortiervorrichtung ein erster Sortiergang und in einem zweiten Segment (44) mit mindestens N Speichermodule (48a - k) der Sortiervorrichtung nachfolgend ein zweiter Sortiergang durchgeführt, wobei im ersten Sortiergang Überlaufsendungen, die einem wegen Füllung geschlossenen Speichermodul (46f) zugeordnet werden, in eines der anderen Speichermodule (46a - e, 46k) abgelegt und in den Sortierprozess des zweiten Sortiergangs eingefügt werden.

IPC 8 full level

**B07C 3/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B07C 3/02** (2013.01 - EP US); **B65H 3/045** (2013.01 - EP US); **B65H 3/34** (2013.01 - EP US); **B65H 5/26** (2013.01 - EP US); **B65H 31/06** (2013.01 - EP US); **B65H 83/025** (2013.01 - EP US); **B65H 2701/1916** (2013.01 - EP US); **Y10S 209/90** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

- DE 19629125 A1 19980129 - SIEMENS AG [DE]
- DE 10039419 C1 20011018 - SIEMENS AG [DE]
- DE 19709232 A1 19971106 - HITACHI LTD [JP]

Citation (search report)

- [X] DE 19709232 A1 19971106 - HITACHI LTD [JP]
- [Y] WO 03015938 A1 20030227 - SIEMENS AG [DE], et al
- [Y] DE 10039419 C1 20011018 - SIEMENS AG [DE]
- [Y] DE 19629125 A1 19980129 - SIEMENS AG [DE]

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 2067535 A1 20090610**; **EP 2067535 B1 20110608**; AT E511928 T1 20110615; DE 102007058580 A1 20090610; US 2009145817 A1 20090611; US 2012241363 A1 20120927; US 8217294 B2 20120710; US 8772664 B2 20140708

DOCDB simple family (application)

**EP 08170817 A 20081205**; AT 08170817 T 20081205; DE 102007058580 A 20071205; US 201213489874 A 20120606; US 32920408 A 20081205